



ローデ・シュワルツとBroadcom社の連携が拡大—最新のWi-Fi 7アクセスポイント用チップセットにも対応

ローデ・シュワルツとBroadcom社は、Broadcom社製の最新Wi-Fi 7アクセスポイント用チップセットについて、R&S CMP180無線通信テストの有効性検証に成功しました。このR&S CMP180とBroadcom社のWi-Fi 7デバイスによるWi-Fi 7試験セットアップのデモンストレーションを、バルセロナで開催されるMobile World Congress 2023のローデ・シュワルツのブースで行います。



キャプション： Broadcom社のWi-Fi 7チップセットをもとにR&S CMP180の有効性を検証できました。

ローデ・シュワルツとBroadcom Inc.社は、次世代Wi-Fi製品の市場投入が可能になるよう協力して取り組んできました。今回、私ども両社はR&S CMP180無線通信テストを使って、最新のBroadcom® 4x4 Wi-Fi 7アクセスポイント用チップセットの検証に成功しました。R&S CMP180は、無線LANルータや家庭用ゲートウェイ、企業規模のアクセスポイントなど、Broadcom Wi-Fi 7チップセットをそれぞれの製品に組み込むためのアクセスポイント・ターミナルに対するBroadcom社の生産試験ツールをサポートしています。先にご報告の通り、ローデ・シュワルツのテスト・ソリューションはすでにBroadcom®モバイル・ハンドセット用のWi-Fi 7チップセットに対応していましたが、これにアクセスポイント用チップセットが加わりました。

次世代Wi-Fiにともなう新たなテスト課題

Wi-Fi 7は、やがて登場するIEEE 802.11be規格にもとづく次世代のWi-Fiです。この新技術は、多数の機能のなかでも極めて高いスループットが特徴であり、たとえばゲームのための低遅延・高速接続のほか、没入型ユーザー・エクスペリエンスを実現するために拡張現実（AR）や仮想現実（VR）を使ったアプリケーションなど、自宅でかつてない体験を楽しめるようになります。

しかしWi-Fi 7アクセスポイントの検証には、帯域幅320 MHzの通信チャネルや6 GHz帯での動作、4096-QAMなど高次の変調方式など最新のWi-Fi機能をサポートすると同時に、最高水準の性能と信頼性に必要なEVM性能や拡張性を備えたテスト・ソリューションが必要です。ローデ・シュワルツのR&S CMP180無線通信テストは、ワイヤレス機器のノンシグナリング・テストのための将来性豊かなソリューションとして、こうした要求にお応えします。

R&S CMP180は、Wi-Fi 6EやWi-Fi 7、8 GHzまでの5G NR FR1を含めた多数のセルラー系/ノンセルラー系技術を最大帯域幅500 MHzでサポートしています。アナライザと信号発生器をそれぞれ2台、8つのRFポートも2セット搭載しており、1台の計測器で2x2 MIMOテストに対応できます。さらに、このR&S CMP180を2台組み合わせると拡張し、アナライザと信号発生器を4台ずつとすることで、4x4 MIMOアクセスポイントを効率的にテストすることも可能です。こうしたことを総合的に考えると、R&S CMP180は現在から将来にわたって最新ワイヤレス技術の試験ニーズに対処できる費用対効果に優れたテスト・ソリューションであると言えます。

Broadcom Inc.社で製品マーケティングを担当するアソシエイト・ディレクターのKevin Narimatsu氏は次のように説明しています。「ローデ・シュワルツとの連携が拡大したことをとても評価しています。これによって、当社は期待通りに超高性能かつ高品質なWi-Fi 7製品を市場に出すことができるようになりました。そのため、お客様にはWi-Fi 7がもたらすであろう新しいワイヤレス体験を自在に活用いただけます」。

ローデ・シュワルツでモバイル無線テストを担当する上級副社長のChristoph Pointnerも次のように述べています。「最新のWi-Fi 7技術についてBroadcom社と緊密に連携できることに大変感謝しています。こうし

たワイヤレス機器のテストに関する知見を活用できるうえ、Wi-Fi 7チップセットやデバイスのメーカーと早くから協力することで、当社のお客様にクラス最高水準のテスト・ソリューションを提供できるようになるからです」。

ローデ・シュワルツは、バルセロナの展示会場Fira Gran Viaで開催されるMobile World Congress 2023において、R&S CMP180とBroadcom社のWi-Fi 7デバイスによるWi-Fi 7向けテスト・セットアップを出展します。ぜひホール5・小間番号5A80の当社ブースまでお越しください。

ローデ・シュワルツのR&S CMP180について詳しくは<https://www.rohde-schwarz.com/product/cmp180>をご覧ください。

お問い合わせ：

欧州（本社）：Christian Mokry（電話：+49 89 4129 13052、email：press@rohde-schwarz.com）

北米：Dominique Loberg（電話：+1 503 523-7951、email：Dominique.Loberg@rsa.rohde-schwarz.com）

アジア太平洋地域：Sze Ming Ng（電話：+603 5569 0011、email：press.apac@rohde-schwarz.com）

R&S®は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. の登録商標です。

すべてのプレスリリースは、画像のダウンロードを含め、<http://www.press.rohde-schwarz.com>からインターネットでご提供しています。

ローデ・シュワルツについて

ローデ・シュワルツは、より安全に“つながる”社会の実現に向けた基盤を整えようと取り組む先駆的企業のなかでも、特に技術指向のグループとして、試験・計測などを始めとする技術システムやネットワークおよびサイバーセキュリティにおけるトップレベルのソリューションを提供しています。設立から85年以上にわたり、世界中の産業界や行政機関のお客様の信頼できるパートナーとして歩んできました。そのローデ・シュワルツでは、2021年6月30日現在、全世界で約13,000名の従業員が活躍しています。2020/2021会計年度（昨年7月から本年6月まで）には独立した企業グループとして23.4億ユーロの売上を達成しました。本社はドイツ・ミュンヘンに構えています。

R&S®はRohde & Schwarz GmbH & Co. KGの登録商標です。

東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル27階

〒160-0023

関野 敏正

電話番号：+81 3 5925 1270/1290

Toshimasa.Sekino@rohde-schwarz.com

www.rohde-schwarz.com/jp